【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成18年11月24日(2006.11.24)

【公開番号】特開2005-129572(P2005-129572A)
【公開日】平成17年5月19日(2005.5.19)
【年通号数】公開・登録公報2005-019
【出願番号】特願2003-360781(P2003-360781)
【国際特許分類】
Ｈ０５Ｋ　3/34　(2006.01)
Ｂ２３Ｋ　1/08　(2006.01)
Ｂ２３Ｋ　3/00　(2006.01)
Ｂ２３Ｋ　31/02　(2006.01)
Ｂ２３Ｋ　101/42　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０５Ｋ　3/34　５０６Ｆ
Ｈ０５Ｋ　3/34　５０３Ｂ
Ｂ２３Ｋ　1/08　３２０Ｚ
Ｂ２３Ｋ　3/00　Ｓ
Ｂ２３Ｋ　31/02　３１０Ｈ
Ｂ２３Ｋ　101:42

【手続補正書】
【提出日】平成18年10月11日(2006.10.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
電子部品が搭載された基板を鉛フリーはんだによってフローはんだ付けするためのフローはんだ付け装置であって、
基板を予備加熱するための第１の予備加熱器と、
前記第１の予備加熱器によって予備加熱された基板の下面にフラックスを塗布するためのフラクサーと、
前記フラックスが塗布された基板を再度予備加熱するための第２の予備加熱器と、
前記第２の予備加熱器によって予備加熱された基板の下面を鉛フリーはんだによってフローはんだ付けするためのはんだ付け機と、
はんだ付けされた基板を冷却するための冷却機と、
基板を移動するコンベアとを備え、
前記第１及び第２の予備加熱器によって、前記はんだ付け装置によるはんだ付け前に、基板の下面と上面との温度差が所定の範囲内になるように設定される、フローはんだ付け装置。
【請求項２】
前記第１及び第２の予備加熱器によって、さらに、基板の上面温度が所定の範囲内になるように設定される、請求項１に記載のフローはんだ付け装置。
【請求項３】
電子部品が搭載された基板を鉛フリーはんだによってフローはんだ付けするためのフローはんだ付け方法であって、

基板の下面にフラックスを塗布し、
基板の下面と上面との温度差が所定の範囲内になるように、前記フラックスが塗布された基板を加熱し、
加熱された基板の下面を鉛フリーはんだによってフローはんだ付けし、
はんだ付けされた基板を冷却する、
ステップを有するフローはんだ付け方法。